

逢甲大學 半導體封裝技術微學程 必選修科目表(114學年度入學學生適用)

科目名稱	一		科目名稱	二		科目名稱	三		科目名稱	四		科目名稱	五	
	上	下		上	下		上	下		上	下		上	下
必修科目														
材料科學導論(一)	3													
材料科學導論(二)		3												
選修科目														
功率半導體封裝技術	3													
三維積體封裝技術		3												

- (1)學程總學分：【9】學分
 (2)本學程必修：【6】學分
 (3)本學程選修：至少【0】學分
 (4)外系選修：至少【6】學分

說明：

一、取得微學程之最低學分數9學分，

1. 學生從基礎、進階、實務課程每個類型至少修習 1~2門科目。

二、承認微學程之科目學分

1. 科目名稱或內容相同者，承認學分數不得重複計算。

2. 修習之科目實際學分數超過 微學程 承認學分數，則以承認學分數計算。如實際學分數低於 微學程 承認學分數，則以實際學分數計算。

3. 未列入本 微學程 課程規劃表內之科目，學生得持課程內容證明申請採計學分，經「半導體封裝技術微學程工作小組」審議通過後，採認為本微學程之科目學分。

三、學生修滿規定之科目學分者，得依逢甲大學 微學程 暨微學程 設置要點第七點規定，經本微學程 審查修畢學分確認後，由學校發給微學程證明書。